

株式会社レスター

2027年3月期 第1四半期 決算補足説明資料

2026年8月7日

<将来の見通しに関する注意事項>

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略は将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績は、様々な外部要因、内部要因の変化により、これらの業績見通しとは異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動並びに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。本資料・データの無断転用はご遠慮ください。

<お問い合わせ先>
レスター 経営管理室
E-mail: irpr@restargp.com

Agenda

- 1 2027年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト P4
- 2 2027年3月期 連結業績予想(上方修正)及び配当予想(増配) P12
- 3 事業TOPICS P16
- 4 Company Profile P18

Agenda

- 1 2027年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト** P4
- 2 2027年3月期 連結業績予想(上方修正)及び配当予想(増配) P12
- 3 事業TOPICS P16
- 4 Company Profile P18

売上高

191,420百万円

(前年同期 133,529百万円)

前年同期比 43.4%増

計画進捗率
前回予想 27.3%
今回予想 25.5%

TOPICS

- 生成AI用などのデータセンター向け需要の拡大に伴い、**一部商材の市場価格が上昇**したことや、**クロスセルの強化**などにより好調に推移（↑）
- デバイス事業における**半導体製造装置など産業機器向け需要の回復**や、前年度に立ち上がった**車載向け新規プロジェクトも寄与**（↑）

営業利益

9,640百万円

(前年同期 1,641百万円)

前年同期比 487.2%増

営業利益率 5.0%

計画進捗率
前回予想 53.5%
今回予想 36.3%

TOPICS

- **一部商材の需給ひっ迫による市場価格の継続的な上昇**や期初から**円安傾向**が続いたことに伴い、売上総利益が増加（↑）
- **豊富なラインカードを活かしたクロスセル**や、一昨年度に設立した合併会社を中心とした**海外におけるビジネス**も好調に推移（↑）
- 売上高が成長する中でも**販売管理費のコントロール**を行い、販売管理費比率として前年同期比で**1.9ポイント低減**（↑）

親会社株主に帰属する四半期純利益

5,430百万円

(前年同期 348百万円)

前年同期比 1,458.5%増

純利益率 2.8%

計画進捗率
前回予想 54.3%
今回予想 40.2%

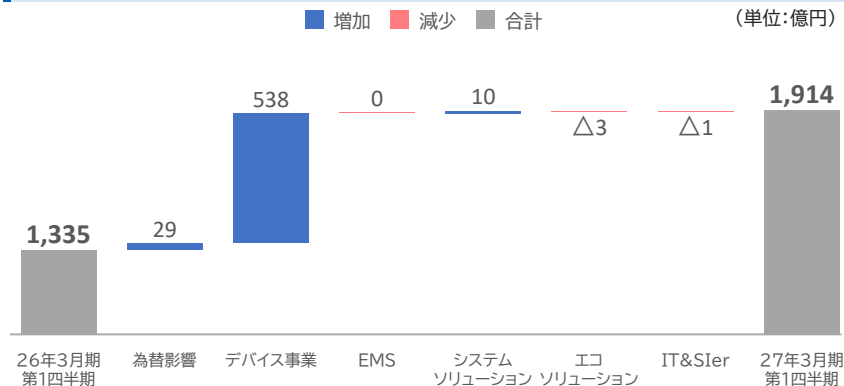
▶ 業績予想の上方修正について

当第1四半期の連結業績を踏まえ、2026年5月14日に公表した2027年3月期通期連結業績予想を上方修正することとしました。

詳細につきましては、本資料の12ページ以降または本件に関する開示資料(<https://pdf.irpocket.com/C3156/xoA3/ieAo/Dbka/lij1.pdf>)をご覧ください。

(単位:百万円)	2026年3月期 第1四半期		2027年3月期 第1四半期		前年同期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	増減率
売上高	133,529	—	191,420	—	57,890	43.4%
売上総利益	10,646	8.0%	18,880	9.9%	8,234	77.3%
販売管理費	9,004	6.7%	9,239	4.8%	235	2.6%
営業利益	1,641	1.2%	9,640	5.0%	7,998	487.2%
経常利益	490	0.4%	8,468	4.4%	7,978	1,627.6%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	348	0.3%	5,430	2.8%	5,082	1,458.5%

売上高



TOPICS(売上高)

デバイス事業：生成AI用などのデータセンター向けの旺盛な需要に対し、クロスセルの強化により好調に推移（↑）

半導体製造装置など産業機器向け需要の回復や、前年度に立ち上がった車載向け新規プロジェクトの寄与（↑）

TOPICS(営業利益)

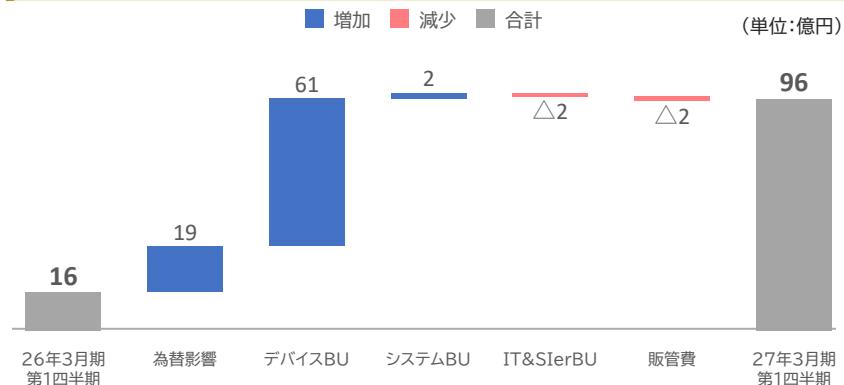
デバイス事業：一部商材の需給ひっ迫による市場価格の継続的な上昇や、期初からの円安傾向に伴う売上総利益の増加（↑）

豊富なラインカードを活かしたクロスセルによる増収効果に伴う増益（↑）

エコソリューション事業：エネルギー価格の高騰に伴う電力の仕入価格の上昇（↓）

全社：売上高が成長する中でも販売管理費のコントロールを行い、販売管理費比率として前年同期比で1.9ポイント低減（↑）

営業利益



為替レート

26年3月期1Q: 144.59円/\$

27年3月期1Q: 159.49円/\$

デバイスビジネスユニット

(単位:百万円)

売上高

セグメント利益

EMS

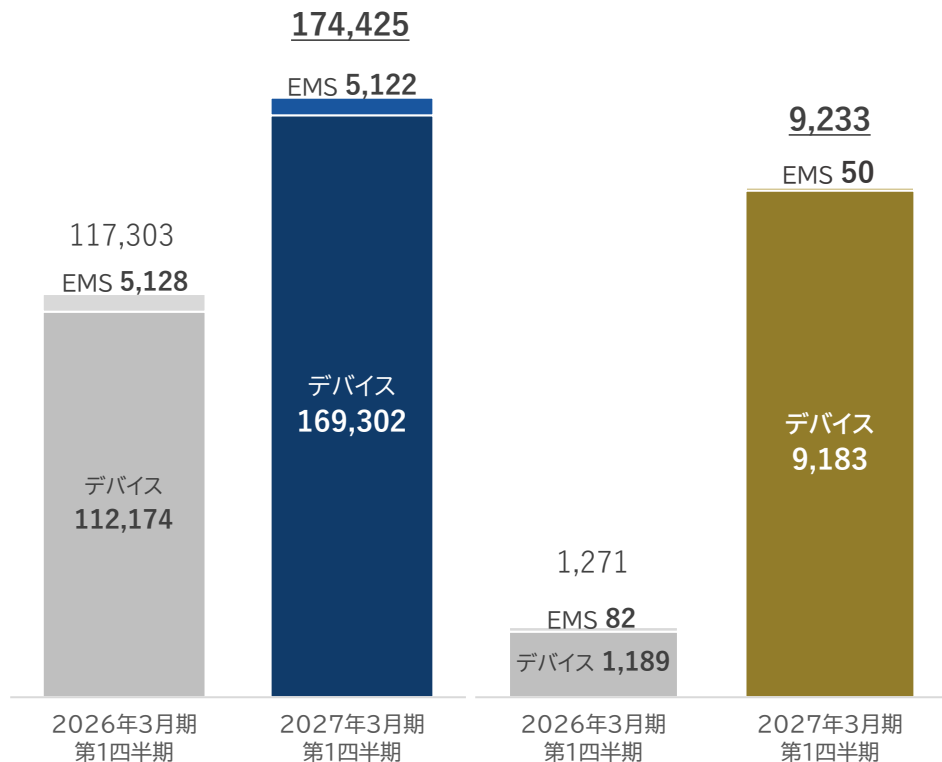
- 対象製品のモデル端境期にあり、売上高は前年並み

デバイス

- 生成AI用などのデータセンター向けの旺盛な需要に対し、クロスセルの強化により好調に推移
- 半導体製造装置など産業機器向け需要の回復や、前年度に立ち上がった車載向け新規プロジェクトの寄与

セグメント利益

- デバイス事業における一部商材の需給ひっ迫による市場価格の継続的な上昇や、期初から円安傾向が続いたことに伴う売上総利益の増加による増益
- 豊富なラインカードを活かしたクロスセルや、一昨年度に設立した合併会社を中心とした海外におけるビジネスが好調に推移

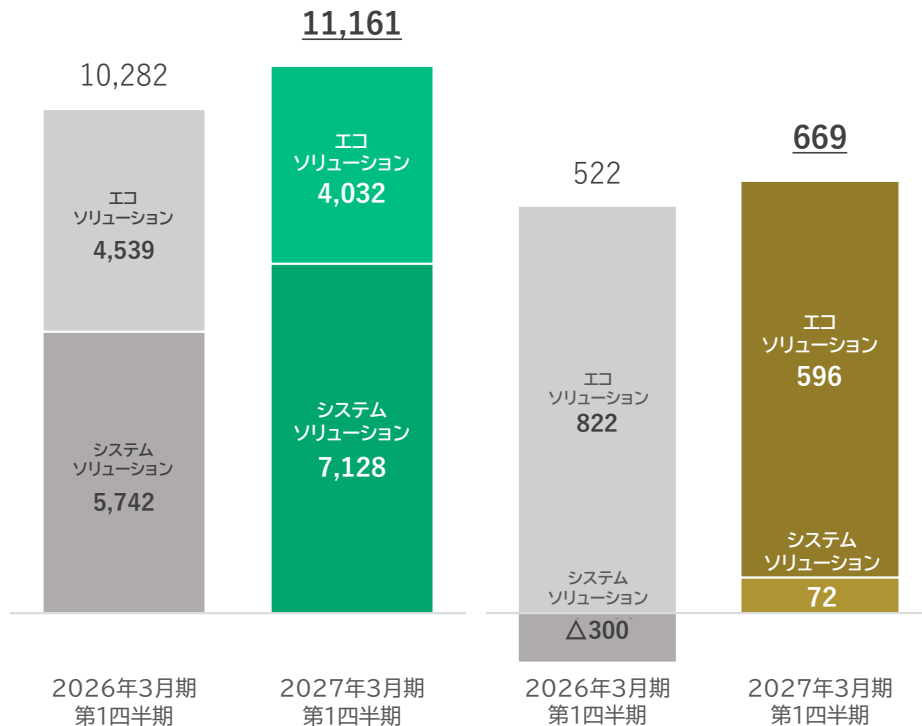


システムビジネスユニット

(単位:百万円)

売上高

セグメント利益



エコソリューション

- ・ 系統用蓄電池の稼働による売上貢献があったものの、太陽光発電における一部地域での電力出力抑制の影響や、新電力分野での競争激化もあり減収

システムソリューション

- ・ データセンター需要の拡大に伴う一部商材の市場価格上昇及び販売好調により増収
- ・ 医療分野における映像システムをはじめとした大型案件受注も増収に寄与

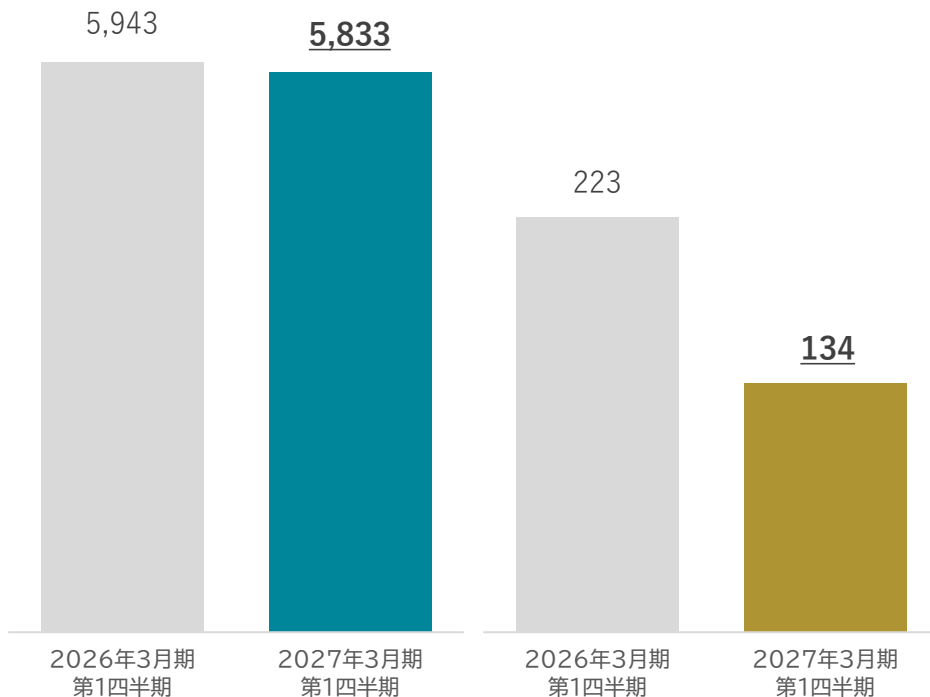
セグメント利益

- ・ エネルギー価格の高騰に伴う電力の仕入価格の上昇によりエコソリューション事業は減益となったものの、システムソリューション事業の増収により増益

(単位:百万円)

売上高

セグメント利益



IT&Sier

AI・クラウド関連案件や複合機向け新モデル、官公庁向けPCの出荷などが堅調に推移したものの、自動車関連におけるソフトウェア開発需要の一時的な停滞や開発計画の変更があったほか、前年同期に計上された大型案件の剥落などの影響により減収

セグメント利益

前年同期の大型案件の剥落による影響に加え、主要部材価格の高騰による製造原価の上昇や、人件費・採用教育費の増加などにより減益

引き続き、当社グループの顧客基盤の活用によるビジネス領域の拡大を図るとともに、更なるデバイスBU、システムBUとのシナジー創出に向けて取り組む

連結貸借対照表

(単位:百万円)

2026年3月末

349,551

現金及び預金 44,930	短期借入金 68,515
売掛債権 144,255	仕入債務 90,329
	流動負債(その他) 22,202
棚卸資産 64,071	固定負債 59,001
流動資産(その他) 27,280	
固定資産 68,984	純資産 109,504
繰延資産 30	

資産の部

負債・純資産の部

(単位:百万円)

2026年6月末

390,327

現金及び預金 45,344	短期借入金 92,066
売掛債権 155,601	仕入債務 103,093
	流動負債(その他) 22,416
棚卸資産 83,840	固定負債 58,429
流動資産(その他) 36,687	
固定資産 68,828	純資産 114,322
繰延資産 26	

資産の部

負債・純資産の部

(単位:百万円)

主な増減要因

資産の部	
流動資産	棚卸資産 +19,769、売掛債権 +11,346
固定資産	—
負債・純資産の部	
流動負債	短期借入金 +23,550、仕入債務 +12,763 賞与引当金 △1,131
固定負債	—
純資産	利益剰余金 +3,518 その他有価証券評価差額金 +626 為替換算調整勘定 +611

自己資本比率^{*1}

26年3月末
26.6%
(28.1%)

26年6月末
25.1%
(26.3%)

ネットD/Eレシオ^{*2}

26年3月末
0.7倍

26年6月末
0.9倍

1株当たり
純資産(円)

26年3月末
3,309.73

26年6月末
3,478.32

^{*1}()内の数字は、ハイブリッドローン(劣後特約付きローン)を加味した格付上の数値(2024年8月に調達したハイブリッドローン(劣後特約付きローン)100億円については格付上の資本性50%を考慮して計算)

^{*2}ネットD/Eレシオ=(リース債務を除く有利子負債－現金及び預金)÷自己資本 →安定的に1.2倍を下回る水準を維持

Agenda

- 1 2027年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト P4
- 2 2027年3月期 連結業績予想(上方修正)及び配当予想(増配) P12**
- 3 事業TOPICS P16
- 4 Company Profile P18

2027年3月期通期業績予想(上方修正)

(単位:百万円)	2026年3月期 通期実績	2027年3月期 通期予想		前回予想比	
	金額	前回発表 (26年5月14日開示)	今回発表 (26年8月7日開示)	増減額	増減率
売上高	630,905	700,000	750,000	50,000	7.1%
営業利益	16,739	18,000	26,500	8,500	47.2%
経常利益	13,762	14,500	21,000	6,500	44.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	7,691	10,000	13,500	3,500	35.0%
一株当たり当期純利益(円)	273.56	355.64	480.12	124.48	—

- ▶ 当第1四半期連結累計期間においては、生成AI用などのデータセンター向け需要の拡大に伴い、一部商材の市場価格動向が上昇したことや、豊富なラインカードを活かしたクロスセルなどにより好調に推移
 - ▶ デバイス事業における半導体製造装置など産業機器向け需要の回復や、前年度に立ち上がった車載向け新規プロジェクトの寄与も業績を押し上げる
 - ▶ 一部商材の単価動向や需要は引き続き好調に推移しており、市場環境の変化を注視しながら更なる業績向上に努める
- このような状況と第1四半期の業績動向を踏まえ、2026年5月14日に公表の通期業績予想を上方修正

ビジネスユニット及び事業別業績予想

		2026年3月期 通期実績	2027年3月期 通期予想		前回予想比	
(単位:百万円)		金額	前回発表 (26年5月14日開示)	今回発表 (26年8月7日開示)	増減額	増減率
売上高	デバイスBU	558,206	615,000	664,000	49,000	8.0%
	デバイス	536,149	595,000	644,000	49,000	8.2%
	EMS	22,057	20,000	20,000	—	—
	システムBU	48,860	60,000	61,000	1,000	1.7%
	システムソリューション	31,493	40,400	41,400	1,000	2.5%
	エコソリューション	17,367	19,600	19,600	—	—
	IT&SIerBU	23,837	25,000	25,000	—	—
	連結	630,905	700,000	750,000	50,000	7.1%
セグメント利益	デバイスBU	14,700	14,650	23,750	9,100	62.1%
	デバイス	14,205	14,300	23,400	9,100	63.6%
	EMS	495	350	350	—	—
	システムBU	3,164	3,800	3,850	50	1.3%
	システムソリューション	1,222	1,300	2,000	700	53.8%
	エコソリューション	1,942	2,500	1,850	△650	△26.0%
	IT&SIerBU	1,219	1,300	1,300	—	—
	全社・調整	△2,345	△1,750	△2,400	△650	—
連結		16,739	18,000	26,500	8,500	47.2%

*2027年3月期より、従来「IT&SIerBU」に計上していた当社の連結子会社である株式会社ブリパテックの事業を「デバイスBU」にて計上しており、2026年3月期 通期実績及び2027年3月期 通期見通しについてはそれぞれ組替後の数値で記載

株主還元方針及び配当予想(増配)

株主還元方針

■ 2027年3月期を最終年度とする中期経営計画の期間の基本方針

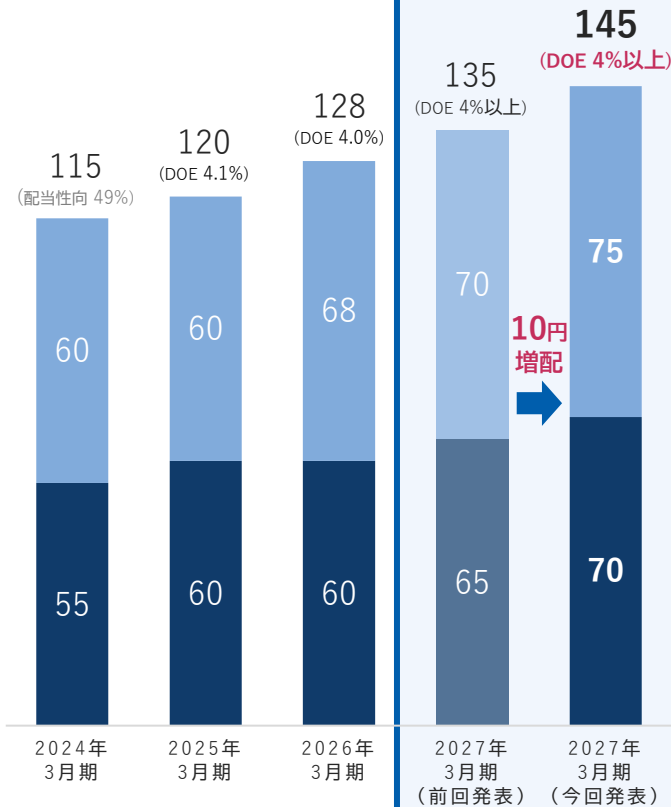
- ・ 安定的な株主還元の充実、成長領域への積極的な投資と財務健全性のバランスを考慮
- ・ 連結株主資本配当率(DOE*)4%以上
- ・ 安定的且つ継続的に増配の実施
- ・ 余剰資金については機動的な自社株買い

*DOE(Dividend on Equity):株主資本配当率 = 配当額÷株主資本 = 配当利回×PBR
株主資本をベースとするため、配当性向に比べて、利益のブレに対する影響が少なく、安定的な配当となります。(2025年3月期より指標を配当性向からDOEへ変更)
当社は、株主の皆様安心して長期保有いただけるよう、DOEを重要な指標として捉えて、株主還元を行ってまいります。

1株当たり配当金

(単位:円)

■ 中間期 ■ 期末



配当予想	2026年3月期	2027年3月期	
	金額	前回発表 (26年5月14日開示)	今回発表 (26年8月7日開示)
中間期末	60円	65円	70円
期末	68円	70円	75円
合計	128円	135円	145円

Agenda

- 1 2027年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト P4
- 2 2027年3月期 連結業績予想(上方修正)及び配当予想(増配) P12
- 3 事業TOPICS P16**
- 4 Company Profile P18

インド市場への新規参入～半導体分野における戦略的パートナーシップの締結～

インド全土に56箇所の営業拠点を展開する、ICT(情報通信技術)製品の大手専門商社である Rashi Peripherals Limited(以下、「RASHI」との間で、インドにおける半導体事業を展開する合弁会社(以下、「JV」)設立に関する諸契約を締結し、2026年10月(予定)よりJVを通じた事業を開始

インド主要都市5拠点のネットワーク



- RASHIが有する販売インフラ・人材・販売ネットワーク等を活用し、迅速かつ効率的にインド市場へ参入
- JVでは、インド市場に向けて各種半導体の本格的な営業活動を開始し、当社が持つ強力なラインカード(取扱商材)の活用や、顧客のニーズに応える必要不可欠な技術サポート(FAE)などのノウハウを提供
- RASHI、当社それぞれが保有するラインカードのクロスセルを推進

注力領域

産業機器領域

新たにインドで商権を獲得した戦略的商材である半導体製品を核に、RASHIの既存ラインカードとの組み合わせにより、産業機器向けセンシングソリューションビジネスに取り組む



車載領域



急速に拡大するインド自動車市場において、車載機器メーカーであるTier1向けにソリューション提案やクロスセルを推進



今後の見通し

成長著しいインド半導体市場における確固たる事業基盤を構築し、グループ全体の事業規模拡大および企業価値向上を目指す



Agenda

- 1 2027年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト P4
- 2 2027年3月期 連結業績予想(上方修正)及び配当予想(増配) P12
- 3 事業TOPICS P16
- 4 Company Profile P18**

Mission

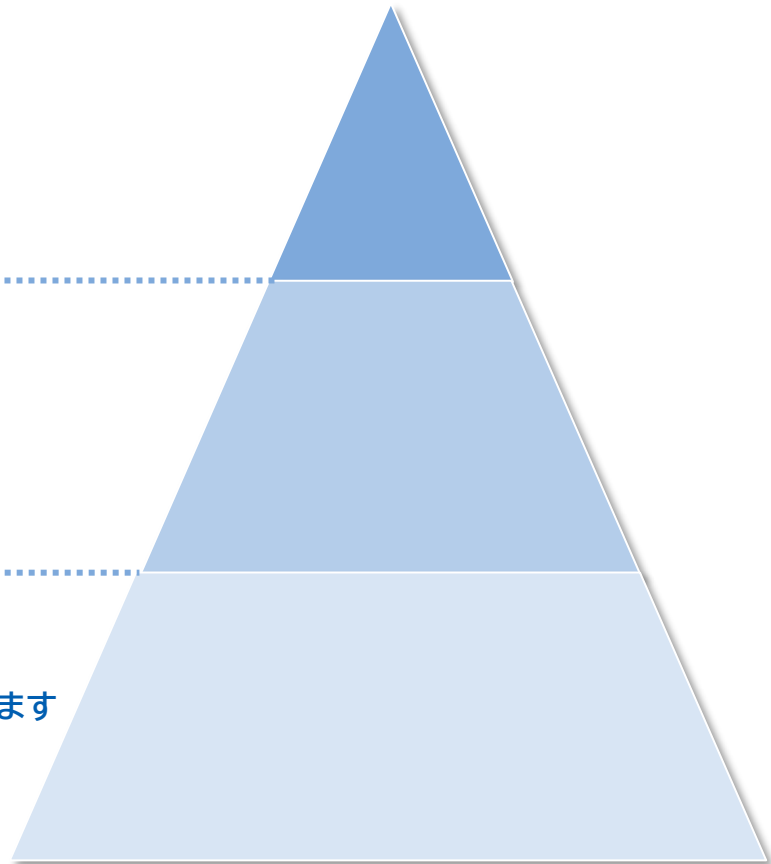
情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、
社会の発展に貢献します

Vision

あらゆるニーズに対応できる
「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指します
世界・社会貢献・共創と革新

Value

多様な考えを受け入れ、共創を通じて、新しい文化や価値を創り出します
常に高い目標を掲げて、革新的な発想と情熱で、挑戦し続けます
活躍の場を世界へと広げ、持続可能な社会の発展に貢献します



レスターグループ事業概要

会社概要



会社名 株式会社レスター（英文名: Restar Corporation）

本社所在地 東京都港区港南二丁目10番9号 レスタービルディング

代表取締役
会長CEO 今野 邦廣
社長COO 林 真一

資本金 43.8億円

従業員数 4,637人(2026年3月末時点)

設立 2009年10月

上場取引所 東京証券取引所 プライム市場

証券コード 3156

事業紹介



*BU:ビジネスユニット

エレクトロニクスに関する世界中の課題を解決する。



最新のIR資料等は[こちら](#)からご覧いただけます。